(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145962 (P2002-145962A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

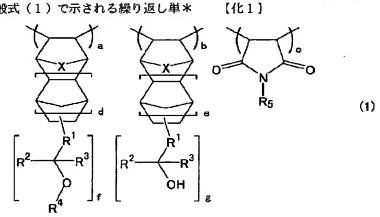
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)	
C08F 222/40		C 0 8 F 222/40	2H025	
232/00		232/00	4 J 0 0 2	
C08K 5/00		C 0 8 K 5/00	4 J 1 0 0	
C 0 8 L 45/00		C 0 8 L 45/00		
G03F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039 6	0 1	
	審查請以	未請求 請求項の数7 OL (全	27 頁) 最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2000-349459(P2000-349459)	(71)出願人 000002060		
		信越化学工業株式 :	会社	
(22) 出顧日	平成12年11月16日(2000.11.16)	東京都千代田区大手町二丁目6番1号		
		(71)出顧人 000005821		
		松下電器産業株式	会社	
		大阪府門真市大字	門真1006番地	
		(71)出顧人 000002200		
		セントラル硝子株	式会社	
		山口県宇部市大宇	中宇部5253番地	
		(74)代理人 100079304		
		弁理士 小島 隆	司 (外2名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】

* 位を含むことを特徴とする髙分子化合物。

下記一般式(1)で示される繰り返し単* 【解決手段】



(式中、R'は単結合又はアルキレン基、R'、R'は水 素原子、フッ素原子、アルキル基、又はフッ素化された アルキル基、R1、R1の両方又はどちらか一方に1個以 上のフッ素原子を含む。R'は酸不安定基である。R'は 水素原子、又はアルキル基であり、酸素、窒素、硫黄な どのヘテロ原子を含んでいてもよい。Xはメチレン基、

エチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。) 【効果】 本発明のパターン形成方法に用いられるレジ スト材料は、高エネルギー線に感応し、180 n m以 下、特には160nm以下の波長における感度、解像性 及びプラズマエッチング耐性に優れている。

【特許請求の範囲】

下記一般式(1)で示される繰り返し単米 【請求項1】

1

(式中、R1は単結合又は炭素数1~4のアルキレン 基、R1、R1は水素原子、フッ素原子、炭素数1~4の アルキル基、又は炭素数1~4のフッ素化されたアルキ ル基であり、R¹、R¹の両方又はどちらか一方に1個以 上のフッ素原子を含む。R¹は酸不安定基であり、0< $a/(a+b+c) < 0.6, 0 \le b/(a+b+c)$ $<0.4.0.2 \le c/(a+b+c) \le 0.7$ cb る。dとeは0又は1、fとgは1又は2である。R' は水素原子、又は炭素数1~10の直鎖状、分岐状もし くは環状のアルキル基であり、酸素、窒素、硫黄などの ヘテロ原子を含んでいてもよい。Xはメチレン基、エチ レン基、酸素原子又は硫黄原子である。〉

【請求項2】 請求項1記載の高分子化合物を含むこと を特徴とするレジスト材料。

【請求項3】 (A)請求項1記載の高分子化合物、

(B) 有機溶剤、(C)酸発生剤を含有するととを特徴 30 は、一般的に0.3ミクロンプロセスに使われ始め、 とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項4】 更に、塩基性化合物を含有する請求項3 記載のレジスト材料。

【請求項5】 更に、溶解阻止剤を含有する請求項3又 は4記載のレジスト材料。

【請求項6】 更に、溶解向上剤を含有する請求項3、 4又は5記載のレジスト材料

(1) 請求項2乃至6のいずれか1項に 【請求項7】 記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100n m以上180nm以下又は1nm以上30nm以下の高 エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する 工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適 したレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料のベース ポリマーとして有用な髙分子化合物並びにこの髙分子化 合物を含むレジスト材料及びこれを用いたパターン形成 50 にはほど遠く、カルボニル、炭素炭素間の2重結合を低

* 位を含むことを特徴とする高分子化合物。

【化1】

方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】LSI の高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化 が急速に進んでいる。微細化が急速に進歩した背景に 20 は、投影レンズの高NA化、レジストの性能向上、短波 長化が挙げられる。特に i 線 (365 nm) から K r F (248 nm)への短波長化は大きな変革をもたらし、 0. 18 μmルールのデバイスの量産も可能となってき ている。レジストの高解像度化、高感度化に対して、酸 を触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料(特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等に記 載)は、優れた特徴を有するもので、遠紫外線リソグラ フィーに特に主流なレジスト材料となった。

【0003】KrFエキシマレーザー用レジスト材料 0.25ミクロンルールを経て、現在0.18ミクロン ルールの量産化への適用、更に0.15ミクロンルール の検討も始まっており、微細化の勢いはますます加速さ れている。KrFからArF(193nm)への波長の 短波長化は、デザインルールの微細化を0.13μm以 下にすることが期待されるが、従来用いられてきたノボ ラックやポリビニルフェノール系の樹脂が193nm付 近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹 脂として用いることができなかった。透明性と、必要な 40 ドライエッチング耐性の確保のため、アクリル系やシク ロオレフィン系の脂環族系の樹脂が検討された(特開平 9-73173号、特開平10-10739号、特開平 9-230595号公報、WО97/33198)。更 に0. 10 μm以下の微細化が期待できるF,(157 nm)に関しては、透明性の確保がますます困難にな り、アクリル系では全く光を透過せず、シクロオレフィ ン系においてもカルボニル基を持つものは強い吸収を持 つことがわかった。ポリビニルフェノールにおいては1 60nm付近の透過率が若干向上するが、実用的レベル

減することが透過率確保のための必要条件であることが 判明した。しかしながら、環構造や炭素炭素間の2重結 合は、ドライエッチング耐性の向上に大きく寄与してお り、ベンゼン環を排除して、エッチング耐性を向上する ために脂環構造を導入したArF用のポリマーはカルボ ン酸で溶解性を出しているために、透明性の確保が難し °¢1

【0004】透明性確保のため、フッ素化アルコールも 検討されている。透明性が最も高いアルカリ性溶解基と して、フッ素化アルコールが挙げられる。フッ素化アル 10 コールを持つシクロオレフィン系レジストのパターン形 成例はhttp://ce055.cm. utexa s. edu/research/157/157_et ch. htm, Proc. SPIE, 3999 37 (2000), Polym. Mater. Sci. En g. 1997, 77, 449-450にて報告されてい る。フッ素化アルコールはカルボニル結合を持たず、更 に、フッ素置換されているため透過率が高い。

【0005】VUV領域の透明性向上のため、フッ素の 導入が効果的であるが、フッ素は非常に疎水性が高い特 性を持っている。フッ素の導入によって現像液のはじき と浸透性の低下が問題になっている。ArF用のレジス トで用いられた現像液の親和性向上ユニットである、無 水物、ラクトン環、カルボン酸などはVUV領域に吸収 がある。アルカリに対して親和性があり、密着性の特性 も兼ね揃えているのがフッ素化アルコールであるが十分 ではない。

【0006】ドライエッチング耐性は、従来エッチング の選択比で議論されることが殆どであった。例えば (J. Photopolymer Sci. and T echnol. Vol 5 No. 3 (1992) p4 39, J. Electrochem. Soc. : Sol id-State Sci. and Technol. Vol. 130, No. 1 January (198 3) p143, SPIE Vol. 2724 p365 (1996)) など多くの論文中において、単層レジス トのドライエッチング選択を数々のパラメータで表すこ とが試みられた。例えば大西バラメータ、リングパラメ ータなどがその代表例である。しかしながら、最近ドラ イエッチング後、レジスト表面に微細なラフネスが発生 し、基板加工してレジスト除去後にレジストのラフネス が転写されるという問題が生じている問題点が指摘され た(SPIE Vol. 3678 p1209(199 9)).

【0007】更に、波長の短波長化において問題となる のは透明性、エッチング耐性の低下だけでなく、ポジ型 レジストの場合、露光量を上げていったときに露光部が 溶解しなくなるネガ化現象が起きることであるという指 摘がある。ネガ化した部分はアルカリ現像液だけでなく アセトンなどの有機溶媒にも不溶となるので、分子間同 50 を用いることを先に提案(特願平11-356220

士が架橋してゲル化が起きていると考えられる。架橋の 原因の一つとして、ラジカルの発生が考えられる。短波 長化により、露光エネルギーが増大し、F、(157n) m) 露光においては、C-C結合やC-H結合までもが 励起されるだけのエネルギーが照射され、励起によって ラジカルが発生し、分子同士が結合する可能性がある。 ArF露光用に用いられる脂環式構造を持つポリマー、 例えば、ポリノルボルネンなどでは、特に顕著なネガ化 現象が観察された。脂環基は橋頭部に多くのC-H結合 を持つため、架橋が進行しやすい構造と考えられる。架 橋を防止するために、αメチルスチレン又はこの誘導体 が効果的であることはよく知られている。しかしなが ら、αメチルスチレンによってネガ化を緩和することは できても、完全に防止することはできなかった。VUV 領域においては酸素の吸収が大きいため、窒素やArな どの不活性ガスによってパージされ、1ppm以下の濃 度にまで酸素濃度を落とした状態で露光される。酸素は 有効なラジカルトラップ剤であるので、発生したラジカ ルの寿命が長く、架橋が進行しやすくなっていると考え られる。レジストポリマーの種類では、特にポリヒドロ キシスチレン系をベースポリマーとしたレジストにおい て、顕著なネガ化現象が観察された。それに比べて、ア クリレートをベースとしたレジストにおいてはネガ化現 象が殆ど見られないこともわかった。更にノルボルネン と無水マレイン酸との交互共重合ポリマーをベースとし たレジストにおいてもネガ化が起きにくいことも判明し た。

【0008】本発明は、上記事情に鑑みなされたもの で、180nm以下、特にF₁(157nm)、Kr 30 , (146 nm), KrAr (134 nm), Ar, (1 26) nmなどの真空紫外光における透明性及びネガ化 防止効果と、ドライエッチング耐性、アルカリ親和性、 密着性に優れたレジスト材料のベースポリマーとして有 用な新規高分子化合物並びにこれを含む化学増幅レジス ト材料及びこのレジスト材料を用いたパターン形成方法 を提供することを目的とする。

[0009]

40

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結 果、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を含む高 分子化合物をレジスト用ベースポリマーとして用いると とによって、透明性とネガ化防止性、エッチング耐性、 高コントラスト性を確保したレジスト材料が得られると とを知見し、本発明をなすに至ったものである。

【0010】透明性を向上させる手段として、フッ素で 置換されたポリマーを用いることが効果的であることが 近年わかってきた。本発明者らは、ArFレジストとし て用いられているアクリルポリマーの透明性を向上する ことを検討し、主鎖がフッ素置換されたアクリル誘導体 (4)

6

号、特願2000-37396号) したが、エッチング 後にレジスト表面に微細なラフネスが発生することがわ かった。

【0011】本発明者らが種々検討した結果、エッチン グ後のラフネスが発生するのは、CF、、CHF、、C、 F_{\bullet} 、 $C_{\bullet}F_{\bullet}$ 、 $C_{\bullet}F_{\bullet}$ などのフロン系ガスを用いて S_{\bullet} Ozをドライエッチングするときに発生し、更にRFバ ワーを大きくして高選択のエッチング、即ち酸化膜が早 くエッチングされる高スループットを狙った条件でラフ ネスが増大することを見出した。更にArF単層レジス 10 トに用いられるポリマーの種類でラフネスが大きく異な ることが分かり、アクリル系のポリマーにおいては非常 に大きなラフネスが発生した。それに比べて、ノルボル ネンと無水マレイン酸との交互共重合ポリマー、ノルボ ルネンのホモポリマー系などのシクロオレフィン系では ラフネスが小さくなった。特にノルボルネンホモポリマ ーにおいては、KrF用のポリヒドロキシスチレンに比 べても小さい値を得ることがわかった。アダマンタンを ペンダントしたアクリルポリマーは、エッチングのスピ ード即ち選択比において良好な値を示し、シクロオレフ ィン系ポリマーに比べても何ら遜色なかったが、酸化膜 とレジストのエッチング速度比が3以上の高選択エッチ ングにおいて、エッチング後の表面をAFMで測定した 表面粗さRmsがアクリル系で15nm以上、シクロオ レフィン系で3 n m以下という結果となった。エッチン グの選択比が必ずしもエッチング後のラフネスと一致し ないことがわかった。

【0012】本発明の高分子化合物の繰り返し単位であ るシクロオレフィン側鎖のフッ素化アルコールは、フェ ノールの水酸基と同程度のアルカリ溶解性を持ち、基板 30 との密着性も持っている。カルボン酸も基板の密着性が 良好で、アルカリ溶解性や、現像液の濡れ性が良好な官 能基であるが、フッ素化アルコールよりも酸性度が高い ため、僅かなカルボン酸量の違いによって特性が大きく 変わり、特性のコントロールが大変難しかった。しかし*

* ながら、フッ素化アルコールは酸性度がカルボン酸より も低く、フェノールと同程度であるため、コントロール しやすい官能基である。更に、フッ素化アルコールは、 ポリマーを重合後に置換基を導入することが可能で、フ ェノールと同じ酸不安定基導入の合成方法を用いること もできる。

【0013】F、露光におけるF、レーザー照射によるレ ジストからのアウトガス発生も問題となっている。F、 レーザー照射後のポリマー膜のFT-IR測定の結果、 ノルボルネン/無水マレイン酸ポリマーは、露光量の増 大に従って無水物に起因するピークの減少が見られ、無 水マレイン酸が開裂している現象が見られた。それに対 して、ノルボルネン/メチルマレイミドポリマーはFT - I Rに何ら変化が見られなかった。F,エキシマレー ザー照射によるレジストからのアウトガスがレンズ表面 に吸着し、レンズの透過率が低下するといわれている。 KrF、ArFにおいてもアウトガスが問題になった が、F₂のアウトガス問題は非常に深刻である。レーザ 一照射によって分解が生じている無水マレイン酸は分解 20 物がアウトガスとなって投影レンズ表面に影響を及ぼす 可能性があると考えられる。

【0014】本発明のポリマーは、シクロオレフィン側 鎖にフッ素化アルコールを持ち、その一部分が酸不安定 基によって置換されており、残りのフッ素化アルコール によって密着性とアルカリ親和性特性を出している。マ レイミドと共重合させることによって、基板との密着性 とアルカリ親和性特性を更に上げる効果を有する。

【0015】よって、透過率、エッチング耐性、アルカ リ親和性、密着性、アウトガスの前記問題に対して本発 明のポリマー及びレジスト材料は有望な材料である。

【0016】従って、本発明は、下記高分子化合物、レ ジスト材料及びパターン形成方法を提供する。

請求項1:下記一般式(1)で示される繰り返し単位を 含むことを特徴とする高分子化合物。

【化2】

(式中、R1は単結合又は炭素数1~4のアルキレン 基、R¹、R³は水素原子、フッ素原子、炭素数1~4の

ル基であり、R'、R'の両方又はどちらか一方に1個以 上のフッ素原子を含む。R¹は酸不安定基であり、0< アルキル基、又は炭素数1~4のフッ素化されたアルキ 50 a/(a+b+c) < 0.6、0≦b/(a+b+c)

(5)

 $<0.4, 0.2 \le c/(a+b+c) \le 0.7$ cb る。dとeは0又は1、fとgは1又は2である。R' は水素原子、又は炭素数1~10の直鎖状、分岐状もし くは環状のアルキル基であり、酸素、窒素、硫黄などの ヘテロ原子を含んでいてもよい。Xはメチレン基、エチ レン基、酸素原子又は硫黄原子である。)

7

請求項2:請求項1記載の髙分子化合物を含むことを特 徴とするレジスト材料。

請求項3:

(A)請求項1記載の高分子化合物、(B)有機溶剤、

(C)酸発生剤を含有することを特徴とする化学増幅ボ ジ型レジスト材料。

請求項4:更に、塩基性化合物を含有する請求項3記載 のレジスト材料。

請求項5:更に、溶解阻止剤を含有する請求項3又は4 記載のレジスト材料。

【0019】 ここで、R1は単結合又はメチレン基、エ チレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチ 30 基、酸素原子又は硫黄原子である。 レン基等の炭素数1~4のアルキレン基、R'、R'は水 素原子、フッ素原子、メチル基、エチル基、プロピル 基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基 等の炭素数1~4のアルキル基、又はこれらアルキル基 の水素原子の一部又は全部がフッ素原子に置換された炭 素数1~4のフッ素化されたアルキル基であり、例えば ジフルオロメチル基、2、2-ジフルオロエチル基、 2. 2. 2-トリフルオロエチル基、3, 3, 3-トリ フルオロプロピル基、2、2、3、3-テトラフルオロ プロビル基、2,2,3,3,3-ベンタフルオロプロ 40 キル基、炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭素数 ビル基などであるが、R'とR'の両方又はいずれか一方 に1個以上のフッ素原子を含む。R'は酸不安定基であ り、その具体例は後述する。

【0020】R'は水素原子、又はメチル基、エチル 基、プロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、ter t-ブチル基、ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシ ル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基等の炭 素数1~10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル 基であり、酸素、窒素、硫黄などのヘテロ原子を含んで いてもよい。R'、R'は水素原子、フッ素原子又はトリ 50

* 請求項6:更に、溶解向上剤を含有する請求項3、4又 は5記載のレジスト材料

請求項7:

(1) 請求項2乃至6のいずれか1項に記載のレジスト 材料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理 後、フォトマスクを介して波長100nm以上180n m以下又は1nm以上30nm以下の高エネルギー線も しくは電子線で露光する工程と、(3)必要に応じて加 熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むて 10 とを特徴とするパターン形成方法。

【0017】以下、本発明につき更に詳しく説明する。 本発明の高分子化合物は、下記一般式(1)で示される 繰り返し単位を含有する。

[0018]

[化3]

 R_5 (1)

フルオロメチル基であり、Xはメチレン基、エチレン

【0021】また、上記式(1)において、a、b、c は、0 < a / (a + b + c) < 0. 6、好ましくは0. $2 \le a / (a+b+c) \le 0.5, 0 \le b / (a+b+c)$ c) < 0. 4、好ましくは $0 \le b / (a + b + c) \le$ 0.3、0.2≦c/(a+b+c)≦0.7、好まし くは0.3 \le c/(a+b+c) \le 0.5である。 【0022】R'で示される酸不安定基としては、種々 選定されるが、特に下記式(2)、(3)で示される 基、下記式(4)で示される炭素数4~40の三級アル 4~20のオキソアルキル基等であることが好ましい。 [0023]

[化4]

$$O = (CH_2)_a - C - O - R^8$$
 (2)

$$\begin{array}{c}
R^7 \\
---C \\
---C \\
R^8
\end{array} \tag{3}$$

[0024]式(2)において、R*は炭素数4~2 0、好ましくは4~15の三級アルキル基、各アルキル 基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭 素数4~20のオキソアルキル基又は上記一般式(4) で示される基を示し、三級アルキル基として具体的に は、tertーブチル基、tertーアミル基、1,1 ージエチルプロピル基、1-エチルシクロペンチル基、 1-ブチルシクロペンチル基、1-エチルシクロペキシ ル基、1-ブチルシクロペキシル基、1-エチル-2-シクロペンテニル基、1-エチル-2-シクロペンテニル基、1-エチル-2-シクロペキセニ* *ル基、2-メチル-2-アダマンチル基等が挙げられ、トリアルキルシリル基として具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチル-tert-ブチルシリル基等が挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、3-オキソシクロヘキシル基、4-メチル-2-オキソオキソラン-5-イル基等が挙げられる。aは0~6の整数である。

10

【0025】式(3)において、R⁷、R⁹は水素原子又は炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロビル基、nーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R⁹は炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、とれらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

[0026]

[化5]

$$+CH_2)_4OH$$
 $+CH_2)_2O(CH_2)_3CH_3$ $-CH_2$ $-CH_2OH$ $+CH_2)_2O(CH_2)_2OH$ $+CH_2)_6OH$ $-CH_2$

【0027】R'とR'、R'とR'、R'とR'とR'とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR'、R'、R'はそれぞれ炭素数 $1\sim18$ 、好ましくは $1\sim10$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0028】上記式(2)の酸不安定基としては、具体的にはtertープトキシカルボニル基、tertープトキシカルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、1,1ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシ

2-シクロベンテニルオキシカルボニル基、1-エチル 30 -2-シクロベンテニルオキシカルボニルメチル基、1 -エトキシエトキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ ドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ ドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

【0029】上記式(3)で示される酸不安定基のうち 直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の基 が例示できる。

[0030]

[化6]

【0031】上記式(3)で示される酸不安定基のうち 環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフランー 2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル 基、テトラヒドロピランー2-イル基、2-メチルテト ラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。式(3) としては、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エト キシプロビル基が好ましい。

【0032】次に、式(4)においてR¹⁰、R¹¹、R¹² は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアル 40 【0034】 キル基等の1価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、 フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、R10とR11、

R1°とR1'、R11とR1'とは互いに結合して環を形成し てもよい。

【0033】式(4)に示される三級アルキル基として は、tertープチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボニル基、1-メチルシクロヘキシル基、1 -エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマ ンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、ter t-アミル基等を挙げることができる。

【化7】

【0035】 ここで、R*は炭素数1~6の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシ ル基、シクロプロビル基、シクロプロビルメチル基、シ クロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等 を例示できる。R10は炭素数2~6の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロ ピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチ ル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピ ル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。R11 は水素原子、炭素数1~6のヘテロ原子を含んでもよい 1価炭化水素基、炭素数1~6のヘテロ原子を介しても よい1価炭化水素基を示す。ヘテロ原子としては、酸素 原子、硫黄原子、窒素原子を挙げることができ、一〇 H、-OR(Rはアルキル基、以下同じ)、-O-、-S-, -S (= O) -, -NH₂, -NHR, -NR₂,- NH-、-NR-として含有又は介在することができ 40 る。

【0036】R¹¹、R¹²としては、水素原子、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシアルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルキル基などを挙げることができ、これらは直鎖状、分岐状、環状のいずれでもよ。*

*い。具体的には、メチル基、ヒドロキシメチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基、プロビル基、イソプロビル基、nーブチル基、secーブチル基、nーペンチル基、nーペキシル基、メトキシ基、メトキシメトキシ基、エトキシ基、tertーブトキシ基等を例示できる。

【0037】また、R*の酸不安定基として用いられる 各アルキル基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシ 30 リル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリ ル基、ジメチルーtertープチルシリル基等が挙げら れる。

【0038】炭素数4~20のオキソアルキル基としては、3-オキソアルキル基、又は下記式で示される基等が挙げられる。

[0039]

[化8]

【0040】また、R'の酸不安定基としては、下記一般式(5)で示されるフッ素原子を含む酸不安定基であってもよい。

[0041]

【化9】

(5)

(式中、R°1、R°1、R°1、R°1、km素原子、フッ素原 50 子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状

(9)

のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R $^{\circ}$ 、R $^{\circ}$ 、R $^{\circ}$ の少なくとも一つはフッ素原子を含む。)

15

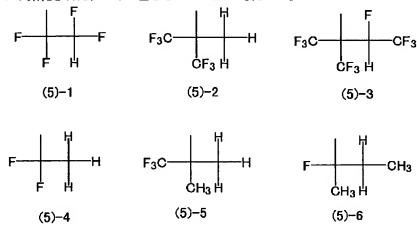
【0042】 CCで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロペキシル基、2-エチルペキシル基、n-オクチル基、デシル基、ドデシル基等が例示でき、特に炭素数1~12、とりわけ1~10

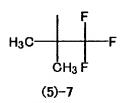
*は、上記アルキル基の水素原子の一部又は全部をフッ素原子に置換した基、例えばトリフルオロメチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、3,3,3-トリフルオロプロビル基、1,1,2,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロビル基などが挙げられる。

【0043】上記式(5)の酸不安定基として、具体的には下記式(5) $-1\sim$ (5) -7で示されるものが挙げられる。

[0044]

のものが好ましい。フッ素化されたアルキル基として *10 【化10】



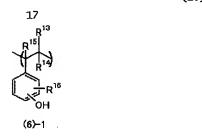


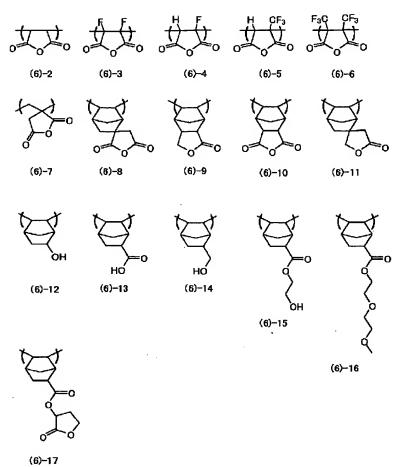
【0045】本発明フッ素アルコール含有シクロオレフィン/マレイミド共重合ポリマーは、シクロオレフィンモノマー側鎖に酸脱離性置換基を含有するが、密着性を向上させるための置換基を含むモノマー、ドライエッチング耐性を向上させるためのモノマー、(メタ)アクリレートモノマーに」由来する単位を含んでいてもよい。密着性向上のためのモノマーとは、フェノール、酸無水

物、エステル(ラクトン)、カーボネート、アルコール、カルボン酸、カルボン酸アミド、スルホン酸アミド、ケトンなどの親水性置換基を含むものであり、例えば下記式(6)-1~(6)-51のようなものが挙げられる。

[0046]

【化11]





[0047]

【化12】

[0048]

【0049】式中 R^1 は前述の通りの酸不安定基、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{13} 、 R^{16} は水素原子、フッ素原子、炭素 数 $1\sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基 又はフッ素化されたアルキル基である。

【0050】とこで、上記密着性を向上させるための置換基を含むモノマー、ドライエッチング耐性を向上させるためのモノマー、(メタ)アクリレートモノマーに由来する単位等、式(1)以外の単位の含有割合は、0~30モル%、特に0~20モル%とすることができ、式(1)の単位は70~100モル%、特に80~100モル%とすることが好ましい。

[0051]また、本発明の高分子化合物の重量平均分子量は2,000~200,000、特に3,000~100,000とすることが好ましい。

【0052】上記高分子化合物を製造する場合、一般的料は、(A)上記高分子には上記単位を与える重合性モノマー類と溶媒を混合有機溶剤、(C)酸発生し、触媒を添加して、場合によっては加熱あるいは冷却 (D)塩基性化合物、しながら重合反応を行う。重合反応は開始剤(あるいは 50 上剤を配合してもよい。

触媒)の種類、開始の方法(光、熱、放射線、ブラズマなど)、重合条件(温度、圧力、濃度、溶媒、添加物)などによっても支配される。本発明の高分子化合物の重合においては、AIBNなどのラジカルによって重合が開始されるラジカル共重合、アルキルリチウムなどの触媒を用いたイオン重合(アニオン重合)などが一般的である。これらの重合は、その常法に従って行うことができる。

【0053】本発明のレジスト材料は特には化学増幅型として有効に用いられ、とりわけ化学増幅ボジ型として用いることが好ましい。

【0054】この場合、本発明のレジスト材料は、本発明の高分子化合物をベース樹脂とする以外は公知の成分を用いて調製し得るが、特に化学増幅ボジ型レジスト材料は、(A)上記高分子化合物(ベース樹脂)、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有する。この場合、更に(D)塩基性化合物、(E)溶解阻止剤、(F)溶解向上剤を配合してもよい。

【0055】ととで、本発明で使用される(B)成分の 有機溶剤としては、酸発生剤、ベース樹脂、溶解阻止剤 等が溶解可能な有機溶媒であればいずれでもよい。この ような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサノン、メ チル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキ シブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、 1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロビレングリコール モノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エ 10 チレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ エチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エ チル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert-ブチ ル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレングリコ ールーモノーtert-ブチルエーテルアセテート等の エステル類が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種 20 以上を混合して使用することができるが、これらに限定 されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の 中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れて いるジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エト キシー2ープロバノール、乳酸エチルの他、安全溶剤で あるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト及びその混合溶剤が好ましく使用される。

【0056】また、フッ素系ポリマーの溶解性を上げる ためにフッ素を含む溶媒を用いることもできる。このよ うなフッ素置換された溶媒を例示すると、2-フルオロ 30 6,9,12,15-ペンタオキサオクタデカン、パー アニソール、3-フルオロアニソール、4-フルオロア ニソール、2,3-ジフルオロアニソール、2,4-ジ フルオロアニソール、2,5-ジフルオロアニソール、 5,8-ジフルオロ-1,4-ベンゾジオキサン、2, 3-ジフルオロベンジルアルコール、1, 3-ジフルオ ロー2ープロパノール、2', 4'ージフルオロプロピ オフェノン、2, 4-ジフルオロトルエン、トリフルオ ロアセトアルデヒドエチルヘミアセタール、トリフルオ ロアセトアミド、トリフルオロエタノール、2, 2, 2 ートリフルオロエチルブチレート、エチルヘプタフルオ 40 ル、1, 1, 1-トリフルオロー2-プロビルアセテー ロブチレート、エチルヘプタフルオロブチルアセテー ト、エチルヘキサフルオログルタリルメチル、エチルー 3-ヒドロキシー4、4、4-トリフルオロブチレー ト、エチルー2ーメチルー4、4、4ートリフルオロア セトアセテート、エチルペンタフルオロベンゾエート、 エチルペンタフルオロプロピオネート、エチルペンタフ ルオロプロピニルアセテート、エチルパーフルオロオク タノエート、エチルー4,4,4ートリフルオロアセト アセテート、エチルー4,4,4ートリフルオロブチレ ート、エチルー4、4、4ートリフルオロクロトネー

ト、エチルトリフルオロスルホネート、エチル-3-(トリフルオロメチル) ブチレート、エチルトリフルオ ロピルベート、S-エチルトリフルオロアセテート、フ ルオロシクロヘキサン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1ープタノール、1,1,1,2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロ-7, 7-ジメチル-4, 6-オクタンジオン、1, 1, 1, 3, 5, 5, 5 ~ ~ プタフルオロベンタン-2, 4-ジオン、3, 3, 4. 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-ペンタノール、 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ヘプタフルオロー2 - ペ ンタノン、イソプロピル-4,4,4-トリフルオロア セトアセテート、メチルパーフルオロデナノエート、メ チルパーフルオロ(2-メチル-3-オキサヘキサノエ ート)、メチルパーフルオロノナノエート、メチルパー フルオロオクタノエート、メチル-2,3,3,3-テ トラフルオロプロピオネート、メチルトリフルオロアセ トアセテート、メチルトリフルオロアセトアセテート、 1, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 6-オクタフルオロー 2, 4-ヘキサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-1-ペンタノール、1H, 1 H, 2H, 2H-パーフルオロ-1-デカノール、パー フルオロ(2,5-ジメチル-3,6-ジオキサンアニ オニック)酸メチルエステル、2H-パーフルオロー5 -メチル-3, 6-ジオキサノナン、1H, 1H, 2 H, 3H, 3H-パーフルオロノナン~1, 2-ジオー ル、1日、1日、9日ーパーフルオロー1ーノナノー ル、1日、1日-パーフルオロオクタノール、1日、1 H, 2H, 2H-パーフルオロオクタノール、2H-パ ーフルオロー5, 8, 11, 14ーテトラメチルー3, フルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシル アミン、パーフルオロー2,5,8-トリメチルー3, 6, 9-トリオキサドデカン酸メチルエステル、パーフ ルオロトリペンチルアミン、パーフルオロトリプロピル アミン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロ ウンデカン-1,2-ジオール、トルフルオロブタノー ル、1, 1, 1-トリフルオロ-5-メチル-2, 4-ヘキサンジオン、1, 1, 1-トリフルオロー2-プロ パノール、3, 3, 3-トリフルオロー1-プロパノー ト、パーフルオロブチルテトラヒドロフラン、パーフル オロ (ブチルテトラヒドロフラン)、パーフルオロデカ リン、パーフルオロ(1,2-ジメチルシクロヘキサ ン)、パーフルオロ(1,3-ジメチルシクロヘキサ ン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルト リフルオロメチルアセテート、トリフルオロメチル酢酸 ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオン酸メチ ル、パーフルオロシクロヘキサノン、プロピレングリコ 50 ールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸ブ

チル、1、1、1-トリフルオロー5、5-ジメチルー 2. 4-ヘキサンジオンなどが挙げられ、これらの1種 を単独で又は2種以上を混合して使用することができる が、これらに限定されるものではない。

25

【0057】なお、有機溶剤の使用量は、全ベース樹脂 100部(重量部、以下同じ)に対して100~5,0 00部、特に200~3,000部が用いられる。

【0058】(C)成分の酸発生剤としては、下記一般 式(7)のオニウム塩、式(8)のジアゾメタン誘導 誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネー ト誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドーイルス ルホネート誘導体等が挙げられる。

$$[0059] (R^{30}), M^{*}K^{-}$$
 (7)

(但し、R30は炭素数1~12の直鎖状、分岐状又は環 状のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素 数7~12のアラルキル基を表し、M'はヨードニウ ム、スルホニウムを表し、K⁻は非求核性対向イオンを 表し、bは2又は3である。)

【0060】R30のアルキル基としてはメチル基、エチ 20 ル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、2-オキソシクロヘキシル基、ノルボルニル基、アダマンチ米

$$R^{31}$$
— SO_2 — C — SO_2 — R^{32}

(但し、R31、R32は炭素数1~12の直鎖状、分岐状 又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素 数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基又は 炭素数7~12のアラルキル基を表す。)

【0062】R***、R***のアルキル基としてはメチル ロベンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基と してはトリフルオロメチル基、1,1,1-トリフルオ ロエチル基、1,1,1-トリクロロエチル基、ノナフ ルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフ ェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェ ニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル ※

(但し、R''、R''、R''は炭素数1~12の直鎖状、 分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル 基、炭素数6~12のアリール基又はハロゲン化アリー ル基又は炭素数7~12のアラルキル基を表す。また、 R''、R''は互いに結合して環状構造を形成してもよ く、環状構造を形成する場合、R34、R35はそれぞれ炭 素数1~6の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表 す。)

【0064】R**、R**、R**のアルキル基、ハロゲン 化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、ア 50 ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、トリフルオ

*ル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、 p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o -メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-te rtーブトキシフェニル基、m-tertーブトキシフ ェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニ ル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、 エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、 4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキ ルフェニル基が挙げられる。アラルキル基としてはベン 体、式(9)のグリオキシム誘導体、β-ケトスルホン 10 ジル基、フェネチル基等が挙げられる。K-の非求核性 対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハ ライドイオン、トリフレート、1,1,1ートリフルオ ロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネー ト等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー ト、1、2、3、4、5-ペンタフルオロベンゼンスル ホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタ ンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられ る。

> [0061] 【化14】

> > (8)

※基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert -ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチル フェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチル フェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、シク 30 基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化ア リール基としてはフルオロベンゼン基、クロロベンゼン 基、1、2、3、4、5-ペンタフルオロベンゼン基等 が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基等が挙げられる。

> [0063] 【化15】

ラルキル基としては、R*1、R*1で説明したものと同様 の基が挙げられる。なお、R34、R35のアルキレン基と してはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレ ン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0065】具体的には、例えばトリフルオロメタンス ルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタン スルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) フェニ ルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸ジフェニルヨ ードニウム、pートルエンスルホン酸(p-tert-

27 ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェ ニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フェ ニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ ス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、 p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p - トルエンスルホン酸 (p-tert-プトキシフェニ ル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルスル 10 ホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-ter t-ブトキシフェニル) スルホニウム、ノナフルオロブ タンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタンスル ホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタン スルホン酸トリメチルスルホニウム、p-トルエンスル ホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキ シル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロへ · キシルメチル(2 – オキソシクロヘキシル)スルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルス 20 -ジメチルグリオキシム、ビス - o - (キシレンスルホ ルホニウム、pートルエンスルホン酸ジメチルフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロ ヘキシルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン 酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム等のオニウム 塩、ビス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス(キシ レンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシル スルホニル) ジアゾメタン、ビス(シクロペンチルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメ 30 タン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタ ン、ピス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビ ス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (t ertープチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (イソアミルス ルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-アミルスルホ ニル) ジアゾメタン、ピス (tert-アミルスルホニ ル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1 - (tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1-(tert-アミルス ルホニル) ジアゾメタン、1-tert-アミルスルホ ニル-1-(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタ ン等のジアゾメタン誘導体、ビスーロー(pートルエン スルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ピス - ο -(p-トルエンスルホニル) - α-ジフェニルグリオキ シム、ビス-o-(p-トルエンスルホニル)-α-ジ シクロヘキシルグリオキシム、ビス-o-(p-トルエ ンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシ ム、ビス-o-(p-トルエンスルホニル)-2-メチ ル-3,4-ペンタンジオングリオキシム、ビス-0-50 オニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタ

(n-ブタンスルホニル) - α-ジメチルグリオキシ ム、ビス-ο-(n-プタンスルホニル)-α-ジフェ ニルグリオキシム、ビスーo-(n-ブタンスルホニ ル) - α - ジシクロヘキシルグリオキシム、ピス - ο -(n-プタンスルホニル)-2,3-ペンタンジオング リオキシム、ビスーoー(nープタンスルホニル)-2 -メチル-3,4-ペンタンジオングリオキシム、ビス - o - (メタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシ ム、ビス-ο-(トリフルオロメタンスルホニル)-α -ジメチルグリオキシム、ピス-o-(1, 1, 1-ト リフルオロエタンスルホニル) - α-ジメチルグリオキ シム、ビス-o-(tert-ブタンスルホニル)-α ージメチルグリオキシム、ビス - o - (パーフルオロオ クタンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス -o-(シクロヘキサンスルホニル $)-\alpha-$ ジメチルグ リオキシム、ビス-ο-(ベンゼンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシム、ピスーo-(p-フルオロベン ゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス $o-(p-tert-\vec{\tau}f)$ ニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - ο - (カン ファースルホニル) - α-ジメチルグリオキシム等のグ リオキシム誘導体、2-シクロヘキシルカルボニル-2 (p-トルエンスルホニル)プロパン、2-イソプロ ビルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロ パン等のβ-ケトスルホン誘導体、ジフェニルジスルホ ン、ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導 体、p-トルエンスルホン酸2, 6-ジニトロベンジ ル、p-トルエンスルホン酸2, 4-ジニトロベンジル 等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1.2.3-トリス(メタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1、2、 3-トリス(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ベ ンゼン、1,2,3ートリス(pートルエンスルホニル オキシ)ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、フタ ルイミドーイルートリフレート、フタルイミドーイルー トシレート、5-ノルボルネン-2、3-ジカルボキシ イミドーイルートリフレート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドーイルートシレート、5-ノル ボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イル-n-ブ 40 チルスルホネート等のイミドーイルースルホネート誘導 体等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸ト リフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン 酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスル ホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス (ptert-ブトキシフェニル)スルホニウム、p-トル エンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエ ンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフ ェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム等の

ン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(イソブ チルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (secープチル スルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホ ニル)ジアゾメタン、ピス(イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (tert-ブチルスルホニル)ジ アゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビスーo-(p-トルエンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビ A = 0 - (n - T a - T オキシム等のグリオキシム誘導体が好ましく用いられ る。なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を 組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性 向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム 誘導体は定在波低減効果に優れるが、両者を組み合わせ ることにより、プロファイルの微調整を行うことが可能 である。

【0066】酸発生剤の配合量は、全ベース樹脂100 部に対して0.2~15部、特に0.5~8部とすると とが好ましく、0.2部に満たないと露光時の酸発生量 20 ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 が少なく、感度及び解像力が劣る場合があり、15部を 超えるとレジストの透過率が低下し、解像力が劣る場合

[0067] 本発明のレジスト材料には、更に塩基性化 合物、溶解阻止剤、溶解向上剤を添加することができ

【0068】塩基性化合物は、酸発生剤より発生する酸 がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制すること ができる化合物が適しており、このような塩基性化合物 れて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、 基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やバターンプ ロファイル等を向上することができる(特開平5-23 2706号、同5-249683号、同5-15823 9号、同5-249662号、同5-257282号、 同5-289322号、同5-289340号公報等記 載)。

【0069】 このような塩基性化合物としては、第一 級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有す 40 ミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、 る含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、 ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニ ル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合 物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられるが、特 に脂肪族アミンが好適に用いられる。

【0070】具体的には、第一級の脂肪族アミン類とし て、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プ ロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミ ン、イソブチルアミン、sec‐ブチルアミン、ter t-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミル 50 誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル

アミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、 ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチル アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラ エチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミ ン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーn ープロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーn-ブ チルアミン、ジイソプチルアミン、ジ-sec-ブチル アミン、ジベンチルアミン、ジシクロベンチルアミン、 ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N -ジメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレ ンジアミン、N、N-ジメチルテトラエチレンペンタミ ン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーn-プロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリーnーブチルア ミン、トリイソブチルアミン、トリーsec-ブチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0071】また、混成アミン類としては、例えばジメ チルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベン ジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミ の配合により、レジスト膜中での酸の拡散速度が抑制さ 30 ン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類 の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、 N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピ ルアニリン、N、N - ジメチルアニリン、2 - メチルア ニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エ チルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリ ン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2, 4-ジニトロアニリン、2, 6-ジ ニトロアニリン、3,5-ジニトロアニリン、N,N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル(p – トリル)ア フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタ レン、ピロール誘導体(例えばピロール、2H-ピロー ル、1-メチルピロール、2,4-ジメチルピロール、 2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等)、 オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサ ゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イ ソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダ ゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フ ェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン

- 1 - ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリ ジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチ ルビロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジ ン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピ リジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピ リジン、4-(1-ブチルペンチル) ピリジン、ジメチ ルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジ ン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリ ジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリ ピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリ ジン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェ ニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、 アミノビリジン、ジメチルアミノビリジン等)、ビリダ ジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラ ゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導 体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール 誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘 導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノ 誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキ サリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテ リジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン 誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,1 0-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノ シン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラ シル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0072】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物 としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン 酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、ア 30 イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。 ルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、 ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ ン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシア*

(式中、R¹¹、R¹²、R¹³、R¹⁷、R¹⁸はそれぞれ独立 して直鎖状、分岐鎖状又は環状の炭素数1~20のアル キレン基、R''、R''、R''、R''、R''は水素原子、 炭素数1~20のアルキル基又はアミノ基を示し、R** ŁR''、R''とR''、R''ŁR''、R''ŁR''ŁR''、

* ラニン等)等が例示され、スルホニル基を有する含窒素 化合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンス ルホン酸ピリジニウム等が例示され、ヒドロキシ基を有 する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒 素化合物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒ ドロキシピリジン、アミノクレゾール、2,4-キノリ ンジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モ ノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノ ールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、プトキシ 10 ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミ ン、2、2'ーイミノジエタノール、2ーアミノエタノ -ル、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1 ーブタノール、4ー(2-ヒドロキシエチル)モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒ ドロキシェトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエ タノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3 ーピペリジノー1,2ープロパンジオール、3ーピロリ リン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン 20 ジノ-1,2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロ リジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、 1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイ ミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル 【0073】更に、下記一般式(10)及び(11)で 示される塩基性化合物を配合することもできる。

> [0074] 【化16】

> > (10)

(11)

R''とR'"はそれぞれ結合して環を形成してもよい。 S、T、Uはそれぞれ0~20の整数を示す。但し、 は水素原子を含まない。)

50 [0075] CCτ, R11, R12, R13, R17, R190

アルキレン基としては、炭素数1~20、好ましくは1 ~10、更に好ましくは1~8のものであり、具体的に は、メチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソ プロピレン基、n-ブチレン基、イソブチレン基、n-ペンチレン基、イソペンチレン基、ヘキシレン基、ノニ レン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキ シレン基等が挙げられる。

33

[0076] また、R''、R''、R''、R''、R''、R''のア ルキル基としては、炭素数1~20、好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6のものであり、これらは直鎖 10 状、分岐状、環状のいずれであってもよい。具体的に は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル 基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ノ ニル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、シクロ ベンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。

【0077】更に、R**とR**、R**とR**、R**とR *6、R**とR**とR**、R**とR**が環を形成する場 合、その環の炭素数は1~20、より好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6であり、またとれらの環は炭 20 チモールフタレイン等が挙げられ、酸に不安定な置換基 素数1~6、特に1~4のアルキル基が分岐していても よい。

【0078】S、T、Uはそれぞれ0~20の整数であ り、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~8の 整数である。

【0079】上記式(10)、(11)の化合物として 具体的には、トリス(2-(メトキシメトキシ)エチ ル) アミン、トリス (2-(メトキシエトキシ) エチ ル) アミン、トリス[2-{(2-メトキシエトキシ) メトキシ} エチル] アミン、トリス {2-(2-メトキ 30 ル) メタン、ビス (4-(1'-エトキシプロビルオキ シエトキシ) エチル) アミン、トリス {2-(1-メト キシエトキシ) エチル) アミン、トリス (2-(1-エ トキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシプロポキシ) エチル} アミン、トリス[2-{(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ}エチル]アミ ン、4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサー 1, 10-ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサ ン、4,7,13,18-テトラオキサー1,10-ジ アザビシクロ[8.5.5]エイコサン、1,4,1 0,13-テトラオキサー7,16-ジアザビシクロオ クタデカン、1-アザー12-クラウン-4、1-アザ -15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6 等が挙げられる。特に第三級アミン、アニリン誘導体、 ピロリジン誘導体、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、 アミノ酸誘導体、ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、 ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコー ル性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体、トリ ス {2-(メトキシメトキシ) エチル) アミン、トリス {2-(2-メトキシエトギシ)エチル}アミン、トリ ス[2-{(2-メトキシエトキシ)メチル}エチル]

アミン、1-アザー15-クラウン-5等が好ましい。 【0080】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又 は2種以上を組み合わせて用いることができ、その配合 量は全ベース樹脂100部に対して0.01~2部、特 にO. 01~1部が好適である。配合量がO. 01部よ り少ないと配合効果がなく、2部を超えると感度が低下 しすぎる場合がある。

【0081】溶解阻止剤としては、酸の作用によりアル

カリ現像液への溶解性が変化する分子量3,000以下 の化合物、特に2,500以下の低分子量フェノールあ るいはカルボン酸誘導体の一部あるいは全部を酸に不安 定な置換基で置換した化合物を挙げることができる。 【0082】分子量2,500以下のフェノールあるい はカルボン酸誘導体としては、ビスフェノールA、ビス フェノールH、ビスフェノールS、4, 4 – ビス (4)- ヒドロキシフェニル) 吉草酸、トリス(4-ヒドロキ シフェニル) メタン、1、1、1-トリス(4'-ヒド ロキシフェニル) エタン、1, 1, 2-トリス(4'-ヒドロキシフェニル) エタン、フェノールフタレイン、

としては、R'と同様のものが挙げられる。

【0083】好適に用いられる溶解阻止剤の例として は、ピス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル)メタン、ビス(4-(2'-テトラヒドロフ ラニルオキシ) フェニル) メタン、ビス (4-tert ーブトキシフェニル)メタン、ビス(4-tertーブ トキシカルボニルオキシフェニル)メタン、ピス(4tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) メタン、ビス(4-(1′-エトキシエトキシ)フェニ シ) フェニル) メタン、2、2 - ビス(4'-(2'' ーテトラヒドロピラニルオキシ))プロパン、2,2-ビス(4'-(2''-テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-tert-プトキシフェニル) プロパン、2,2-ビス(4'-t ertーブトキシカルボニルオキシフェニル)プロバ ン、2,2-ビス(4-tert-ブトキシカルボニル メチルオキシフェニル)プロパン、2、2-ビス(4) −(1' ' −エトキシエトキシ)フェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4'-(1''-エトキシプロビルオキ シ)フェニル)プロパン、4、4-ビス(4'-(2' '-テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) 吉 草酸tertーブチル、4,4-ビス(4'-(2'' -テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)吉草酸 t e r t - ブチル、4, 4 - ピス (4' - tert - ブトキ シフェニル)吉草酸tert-ブチル、4,4-ビス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) 吉草酸tert-ブチル、4、4-ビス(4'-ter t-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) 吉草酸 50 tert-ブチル、4,4-ビス(4'-(1''-エ

トキシエトキシ)フェニル) 吉草酸 t e r t - ブチル、 4, 4-ビス(4'-(1''-エトキシプロピルオキ シ)フェニル) 吉草酸 t e r t - ブチル、トリス (4 -(2'ーテトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタ ン、トリス(4-(2'-テトラヒドロフラニルオキ シ) フェニル) メタン、トリス (4-tert-ブトキ シフェニル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシ カルボニルオキシフェニル)メタン、トリス(4-te rt-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル)メタ ン、トリス(4 - (1' -エトキシエトキシ)フェニ ル) メタン、トリス(4-(1 ' -エトキシプロピルオ キシ) フェニル) メタン、1, 1, 2-トリス(4'-(2' '-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)エ タン、1, 1, 2-トリス(4'-(2''-テトラヒ ドロフラニルオキシ)フェニル)エタン、1,1,2-トリス(4'-tert-プトキシフェニル)エタン、 1, 1, 2-トリス(4'-tert-ブトキシカルボ ニルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフ ェニル) エタン、1, 1, 2-トリス(4'-(1'-エトキシエトキシ)フェニル)エタン、1,1,2-ト リス(4'-(1'-エトキシプロビルオキシ)フェニ ル) エタン等が挙げられる。

35

【0084】本発明のレジスト材料中における溶解阻止剤の添加量としては、レジスト材料中の固形分100部に対して20部以下、好ましくは15部以下である。20部より多いとモノマー成分が増えるためレジスト材料の耐熱性が低下する。

【0085】本発明で使用できる溶解向上剤はフッ素を 含むベースポリマーの有する疎水性を改善する目的で使 30 用される。即ち、VUVエキシマレーザーの照射によっ てベースポリマーが水溶化又はアルカリ可溶化したとし ても光照射されない部分の疎水性が高すぎる場合は現像 液の濡れ性が低く、効率のよい現像工程が取り得ないと とがある。そこで、あらかじめ水溶性化合物を添加する ことが高解像度を確保するために有効な手段となる。本 発明に使用できる溶解向上剤としては公知の水溶性化合 物、水溶性樹脂、アルカリ可溶性化合物、アルカリ可溶 性樹脂などであれば特に制限なく使用できる。との際、 VUV波長における透明性を高めるため、フッ素化され 40 た化合物であってもよい。即ち、アルキレングリコール 又はそのオリゴマーや重合体、カルボン酸含有化合物や 高酸価の樹脂、ヒドロキシ基含有化合物や高ヒドロキシ 価の樹脂などが好適であるが、その他としてアミン、ア ミド、シラノール、イミド、スルホン酸など水溶性置換 基を含有した化合物又は樹脂も使用できる。溶解阻止剤 の添加量としては、レジスト材料中の固形分100部に 対して20部以下、好ましくは15部以下である。20 部より多いとモノマー成分が増えるためレジスト材料の 耐熱性が低下する。

【0086】本発明のレジスト材料には、ベース樹脂として本発明の組成物以外にポリアクリル酸及びその誘導体、ノルボルネン誘導体-無水マレイン酸交互重合体及びポリアクリル酸又はその誘導体との3あるいは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体-無水マレイン酸交互重合体及びポリアクリル酸又はその誘導体との3あるいは4元共重合体、ノルボルネン誘導体-マレイミド交互重合体及びポリアクリル酸又はその誘導体との3あるいは4元共重合体、テトラシクロドデセン誘導体-マレイミド交互重合体及びポリアクリル酸又はその誘導体との3あるいは4元共重合体、あるいはポリノルボルネン及びメタセシス開環重合体から選択される1種あるいは2種以上の高分子重合体をブレンドすることが可能である。

【0087】本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0088】ここで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、含フッ素オルガノシロ キサン系化合物等が挙げられる。例えばフロラード「F C-430」、「FC-431」(いずれも住友スリー エム(株)製)、サーフロン「S-141」、「S-1 45」、「S-381」、「S-383」(いずれも旭 硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS -403」、「DS-451」(いずれもダイキン工業 (株) 製)、メガファック「F-8151」、「F-1 71], $\lceil F-172 \rfloor$, $\lceil F-173 \rfloor$, $\lceil F-17 \rceil$ 7」(大日本インキ工業(株)製)、「X-70-09 2」、「X-70-093」(いずれも信越化学工業 (株) 製) 等を挙げるととができる。好ましくは、フロ ラード「FC-430」(住友スリーエム(株)製)、 「X-70-093」(信越化学工業(株)製)が挙げ られる。

【0089】本発明のパターン形成方法においては、公知のリソグラフィー技術を採用して行うことができる。40 例えばシリコンウエハー等の基板上にスピンコーティング等の手法で膜厚が0.01~0.5μmとなるように塗布し、これをホットプレート上で60~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~150℃、30秒~5分間プリベークする。次いで目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざす。本発明においては波長180nm以下の遺紫外線、エキシマレーザーを好ましくは0.5~100mJ/cm²程度となるように照射した後、ホットプレート上で60~150℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30秒~3分間ポストエクスポージャベーク(PEB)す

る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラ メチルアンモニウムハイドロオキサイド (TMAH)等 のアルカリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好 ましくは30秒~2分間、浸漬(dip)法、パドル (puddle)法、スプレー(spray)法等の常 法により現像することにより基板上に目的のパターンが 形成される。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線 の中でも193nmのArFより短波長の157nmの F₂, 146nmOKr₂, 134nmOKrAr, 12 6nmのAr,などのエキシマレーザー、X線及び電子 線による微細パターンニングに最適である。また、上記 範囲を上限及び下限から外れる場合は、目的のパターン を得ることができない場合がある。

[0090]

【発明の効果】本発明のバターン形成方法に用いられる レジスト材料は、高エネルギー線に感応し、180nm 以下、特には160nm以下の波長における感度、解像 性及びプラズマエッチング耐性に優れている。従って、 これらの特性より、特にF₂エキシマレーザーの露光波 長でのレジスト材料となり得るもので、微細でしかも基 20 板に対して垂直なパターンを容易に形成でき、このため 超LSI製造用の微細パターン形成方法として好適であ る。

[0091]

【実施例】以下、本発明を具体的に説明するが、本発明 は下記実施例に制限されるものではない。

【0092】[合成例1]5-{2-(tert-ブト キシカルボニルオキシ)-2,2-ビストリフルオロメ チル} エチルー2-ノルボルネン(モノマー1)の合成 200mLのオートクレーブにジシクロペンタジェン -ブテン-1-オール(43.8g)を仕込み、180 ℃で2時間撹拌した。反応混合物を減圧蒸留し、19. ロメチル) エチルー2-ノルボルネン(モノマー2)を 得た(沸点84-88℃/3.33kPa)。

【0093】得られたモノマー2をピリジン170gに 溶解させ、その中にTHF25gに溶かした二炭酸ジー tert-プチル16.4gを滴下し、40℃で1時間 撹拌した。反応系より溶媒を減圧留去した後、シリカゲ 40 ルカラムクロマトグラフィーにより精製を行い、24. 6gのモノマー1を得た(収率92%)。得られた化合 物の同定はマススペクトル、'H-NMR、'3C-NM R、IRによって行った。

【0094】[合成例2]5-{2-(1'-エトキシ エチル) -2, 2-ビストリフルオロメチル} エチルー 2-ノルボルネン(モノマー3)の合成 合成例1と同様の手法で合成したモノマー2の20gを 注意深く脱水した後、無水THF80gに溶解させた。

ニルエーテル5.5gを滴下し、その後室温で1時間撹 拌した。アンモニア水を添加して反応を終了させた後、 溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィ ーにより精製を行い、22.5gのモノマー3の化合物 を得た(収率89%)。得られた化合物の同定はマスス ベクトル、1H-NMR、13C-NMR、IRによって 行った。

【0095】[合成例3]5-{2-(tert-ブト

38

キシカルボニルオキシ) -2-トリフルオロメチル} エ 10 チル-2-ノルボルネン (モノマー4)の合成 200mLのオートクレープにジシクロペンタジエン (15.2g)と1-トリフルオロメチル-3-ブテン -1-オール(37.2g)を仕込み、180℃で2時 間撹拌した。反応混合物を減圧蒸留し、18.9gの5 - (2-ヒドロキシ-2-トリフルオロメチル) エチル -2-ノルボルネン (モノマー5)を得た (沸点97-99℃/3.33kPa)。

【0096】得られたモノマー5をピリジン170gに 溶解させ、その中にTHF25gに溶かした二炭酸ジー tert-ブチル13.2gを滴下し、40℃で1時間 撹拌した。反応系より溶媒を減圧留去した後、シリカゲ ルカラムクロマトグラフィーにより精製を行い、19. 8gのモノマー4を得た(収率92%)。得られた化合 物の同定はマススペクトル、'H-NMR、''C-NM R、IRによって行った。

【0097】[合成例4]5-{2-(1'-エトキシ エチル) -2-トリフルオロメチル} エチル-2-ノル ボルネン(モノマー6)の合成

合成例3と同様の手法で合成したモノマー5の20gを 30 注意深く脱水した後、無水THF80gに溶解させた。 メタンスルホン酸0.22gを添加後、系中にエチルビ ニルエーテル4.4gを滴下し、その後室温で1時間撹 拌した。アンモニア水を添加して反応を終了させた後、 溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィ ーにより精製を行い、18.0gのモノマー6の化合物 を得た(収率89%)。得られた化合物の同定はマスス ベクトル、1H-NMR、13C-NMR、IRによって 行った。

【0098】 [合成例5] モノマー1/モノマー2/N -メチルマレイミド(30/20/50)の共重合(ポ リマー1)

300mLのフラスコにモノマー1を10.1g、モノ マー2を4.9g、N-メチルマレイミドを5.0g仕 込み、溶媒としてジオキサンを5g投入した。この反応 容器を窒素雰囲気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、 窒素ブローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開 始剤としてアゾビスジメチルバレロニトリルを0.89 g加え、60℃まで昇温後、15時間反応させた。との 反応溶液を、イソプロピルアルコール5 L に沈澱させ、 メタンスルホン酸0.28gを添加後、系中にエチルビ 50 得られた白色固体を濾過後、60℃で減圧乾燥し、白色

重合体12.8gを得た。

【0099】得られた重合体の1H-NMR、13C-N MR、GPCの測定を行ったところ、以下の分析結果と なった。

39

共重合組成比

+27-1:+27-2:N-3+11:19:50

重量平均分子量(Mw)=8、700 分子量分布(Mw/Mn)=1.63

- メチルマレイミド (40/10/50) の共重合(ボ リマー2)

300mLのフラスコにモノマー3を12.5g、モノ マー2を2.5g、N-メチルマレイミドを5.0g仕 込み、溶媒としてジオキサンを5g投入した。この反応 容器を窒素雰囲気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、 窒素ブローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開 始剤としてアゾビスジメチルバレロニトリルを0.90 g加え、60℃まで昇温後、15時間反応させた。この 反応溶液を、イソプロピルアルコール5 Lに沈澱させ、 得られた白色固体を濾過後、60℃で減圧乾燥し、白色 重合体13.1gを得た。

【0101】得られた重合体の1H-NMR、13C-N MR、GPCの測定を行ったところ、以下の分析結果と なった。

共重合組成比

モノマー3:モノマー2:N-メチルマレイミド=4 1:9:50

重量平均分子量(Mw)=8,400 分子量分布 (Mw/Mn) = 1.65

【0102】「合成例7]モノマー4/モノマー5/N - メチルマレイミド (30/20/50) の共重合(ポ リマー3)

300mLのフラスコにモノマー4を9、8g、モノマ -5を4.5g、N-メチルマレイミドを5.7g仕込 み、溶媒としてジオキサンを5g投入した。この反応容 器を窒素雰囲気下、−70℃まで冷却し、減圧脱気、窒 素ブローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始 剤として和光純薬製V-65を1.0g加え、60℃ま で昇温後、15時間反応させた。この反応溶液を、イソ 40 重量平均分子量(Mw)=9,500 プロビルアルコール5Lに沈澱させ、得られた白色固体 を濾過後、60℃で減圧乾燥し、白色重合体12.2g を得た。

【0103】得られた重合体の1H-NMR、13C-N MR、GPCの測定を行ったところ、以下の分析結果と なった。

共重合組成比

モノマー4:モノマー5:N-メチルマレイミド=3 0:19:51

重量平均分子量(Mw)=8,300

分子量分布 (Mw/Mn) = 1.58

【0104】[合成例8]モノマー6/モノマー5/N -メチルマレイミド(40/10/50)の共重合(ボ リマー4)

300mLのフラスコにモノマー6を12.0g、モノ マー5を2、3g、N-メチルマレイミドを5、7g仕 込み、溶媒としてジオキサンを5g投入した。この反応 容器を窒素雰囲気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、 窒素ブローを3回繰り返した。室温まで昇温後、重合開 【0100】[合成例6] モノマー3/モノマー2/N 10 始剤として和光純薬製V-65を1.0g加え、60℃ まで昇温後、15時間反応させた。この反応溶液を、イ ソプロピルアルコール5Lに沈澱させ、得られた白色固 体を濾過後、60℃で減圧乾燥し、白色重合体12.6 gを得た。

> 【0105】得られた重合体の1H-NMR、13C-N MR、GPCの測定を行ったところ、以下の分析結果と なった。

共重合組成比

モノマー6:モノマー5:N-メチルマレイミド=3 20 9:10:51

重量平均分子量(Mw)=8,100 分子量分布 (Mw/Mn) = 1.66

【0106】[合成例9]モノマー3/N-メチルマレ イミド(50/50)の共重合(ポリマー5) 300mLのフラスコにモノマー3を14.2g、N-メチルマレイミドを5.7g仕込み、溶媒としてジオキ サンを5g投入した。との反応容器を窒素雰囲気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、窒素ブローを3回繰り返 した。室温まで昇温後、重合開始剤としてアゾビスジメ 30 チルバレロニトリルを1.0g加え、60℃まで昇温 後、15時間反応させた。この反応溶液を、イソプロピ ルアルコール5 Lに沈澱させ、得られた白色固体を濾過 後、60℃で減圧乾燥し、白色重合体12.6gを得

【0107】得られた重合体の'H-NMR、''C-N MR、GPCの測定を行ったところ、以下の分析結果と なった。

共重合組成比

モノマー3:N-メチルマレイミド=50:50

分子量分布 (Mw/Mn) = 1.98

【0108】 [合成例10] モノマー2/N-メチルマ レイミド(50/50)の共重合後酸不安定基修飾 300mLのフラスコにモノマー2を17.8g、N-メチルマレイミドを5.7g仕込み、溶媒としてジオキ サンを5g投入した。この反応容器を窒素雰囲気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、窒素ブローを3回繰り返 した。室温まで昇温後、重合開始剤としてアゾビスジメ チルパレロニトリルを1.0g加え、60℃まで昇温

50 後、15時間反応させた。この反応溶液を、イソプロビ

ルアルコール5Lに沈澱させ、得られた白色固体を濾過 後、60℃で減圧乾燥し、白色重合体12.6gを得 た。

【0109】得られた白色重合体を無水THF80gに 溶解させた。メタンスルホン酸0.28gを添加後、系 中にエチルビニルエーテル6.5gを滴下し、その後室 温で1時間撹拌した。アンモニア水を添加して反応を終 了させた後、溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロ マトグラフィーにより精製を行い、得られた重合体の1 H-NMR、13C-NMR、GPCの測定を行ったとて 10 0℃で減圧乾燥し、白色重合体10.2gを得た。得ら ろ、以下の分析結果となり、合成例6のポリマー2とほ ぼ同じ組成になった。

共重合組成比

モノマー2:N-メチルマレイミド=50:50 1-エトキシエチル置換率80% 重量平均分子量 (Mw) = 9, 300 分子量分布(Mw/Mn)=1.85 【0110】[比較合成例1]ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2-カルボン酸(tertブチル) **/N-メチルマレイミド(50/50)の共重合(ポリ 20 【化17】** マー6)

300mLのフラスコにビシクロ[2.2.1] ヘプト -5-エン-2-カルボン酸(tertブチル)を10 g、N-メチルマレイミドを5.7g仕込み、溶媒とし てジオキサンを5g投入した。この反応容器を窒素雰囲 気下、-70℃まで冷却し、減圧脱気、窒素ブローを3 回繰り返した。室温まで昇温後、重合開始剤として和光 純菜製V-65を1.0g加え、60℃まで昇温後、1 5時間反応させた。この反応溶液を、イソプロピルアル コール5 Lに沈澱させ、得られた白色固体を濾過後、6 れた重合体の'H-NMR、''C-NMR、GPCの測 定を行ったところ、以下の分析結果となった。

42

共重合組成比

ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2-カルボ ン酸(tertプチル): N-メチルマレイミド=5 0:50

重量平均分子量(Mw)=7,300 分子量分布(Mw/Mn)=1.85 [0111]

$$F_{3}C \longrightarrow CF_{3} F_{3}C \longrightarrow CF_{3} CF_{3}$$

$$O \longrightarrow CH_{3}$$

$$O \longrightarrow CH_{3}$$

[0112]

ポリマー6 比較合成例1

【0113】次に、上記ポリマーを下記のようにして評 価した。

ボリマー透過率測定:上記合成例で得られたボリマー1 gをプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテー

のフィルターで濾過して、ポリマー溶液を調製した。 【0114】上記ポリマー溶液をMgF,基板にスピン コーティングし、ホットプレートを用いて100℃で9 0秒間ベークし、厚さ200nmのポリマー層をMgF ト (PGMEA) 10gに十分に溶解させ、0.2μm 50 』基板上に作成した。真空紫外光度計(日本分光製、V

UV200S) を用いて248nm、193nm、15 * 【0115】 7 n mにおける透過率を測定した。結果を表1に示す。* 【表1】

45

	透過率 248nm(%)	透過率 193nm(%)	透過率 157nm(%)
# J₹- 1	87	65	43
オリマー 2	88	68	48
å° J <i>マ</i> − 3	87	70	38
å° Jマ− 4	86	68	43
#° Jマ~ 5	86	69	39
カ゚リマ-6 (比較例)	85	26	15

【0116】また、上記ポリマー溶液をSi基板にスピ ンコートし、ホットプレートを用いて100℃で90秒 間ベークして膜厚300nmのポリマー膜を作成した。 ポリマー膜を作成したウエハーを、下記の方法で評価し た。

ドライエッチング耐性 (CHF,/CF,系ガスでのエッ チング試験)

東京エレクトロン株式会社製ドライエッチング装置TE -8500Pを用い、エッチング前後のポリマー膜の膜 厚差、エッチング後の表面の凹凸をAFMで測定した。

結果を表2に示す。エッチング条件は下記に示す通りで※

※ある。

チャンパー圧力 40.0Pa RFパワー 1300W ギャップ $9 \, \text{mm}$ CHF,ガス流量 $30 \,\mathrm{m}\,\mathrm{l}/\mathrm{m}\,\mathrm{i}\,\mathrm{n}$ CF₄ガス流量 30m1/minArガス流量 100m1/min時間 60sec

[0117]

【表2】

	CHF。JCF。系がエッチング・速度 (nm/min)	ェザング 後の表面 57 ね Rms(nm) 6.3	
#" y ~ 1	92		
ポリマー2	93	4.6	
\$° y ₹~ 3	91	3.5	
it° yマー 4	92	4.5	
‡" y ~- 5	96	4.6	
ポリヤ-6 (比較例)	88	4.2	

【0118】以下、上記ポリマーをベース樹脂として用 いた化学増幅ポジ型レジスト材料の評価例を示す。

[実施例、比較例]

レジスト感度特性:ポリマー1~5、比較例として重量 平均分子量(Mw)=7,300、分子量分布(Mw/ Mn)=1.85のポリマー6、酸発生剤(PAG1, 2)、塩基性化合物、添加剤を表2に示す組成で、フッ 素系界面活性剤FC-430(住友スリーエム(株) 製)を100ppm含有したプロピエングリコールモノ させ、0. 1μmのPTFEフィルターで濾過してレジ スト溶液を調製した。

【0119】得られたレジスト液を、ヘキサメチルジシ

ラザン (HMDS) のベーパープライムを90℃で60 秒間行ったシリコンウエハー上に塗布して、ホットプレ ートを用いて100℃で90秒間ベークし、レジストの 厚みを200nmの厚さにした。

【0120】F,エキシマレーザー露光装置、VUVE S(リソテックジャパン社製)にてオープンフレームで 露光して、露光後直ちに110℃で90秒間ベークし、 2. 38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの 水溶液で60秒間現像を行って、露光量と残膜特性を求 メチルエーテルアセテート(PGMEA)に十分に溶解 40 め、膜厚が0になるときの露光量(Eth)と傾き(ァ 値)を求めた。結果を表3に示す。

[0121]

【表3】

#, l.4-	酸発生剤 (重量部)	塩基性 化合物 (重量部)	溶媒 (重星部)	添加剤 (重量部)	感度 (mJ/ cm²)	γ値
#* y ~- 1 (100)	PAG1 (2)	トリプ・ <i>チル</i> ブミン (0.1)	PGMEA (2100)	-	30	16
ポリマー2 (100)	PAG1 (2)	トリプ・チルフミン (0.1)	PGMEA (2100)	-	20	11
ポリマー3 (100)	PAG1 (2)	トリプ・チ <i>ル</i> フミン (0.1)	PGMEA (2100)	-	24	13
ታ ባ ≁-4 (100)	PAG1 (2)	トリプ・チルブミン (0.1)	PGMEA (2100)	•	28	15
ポリマーち (100)	PAG1 (2)	トリブ・チルブミン (0.1)	PGMEA (2100)	-	29	15
ポリマー1 (100)	PAG1 (2)	TMMEA (0.1)	PGMEA (2100)	•	27	17
ส" ∫ <- 1 (100)	PAG2 (2)	トリプ・チルフミン (0.1)	PGMEA (2100)	•	16	15
*	PAG1 (2)	トリフ* チルブミン (0.1)	PGMEA (2100)	溶解 阻止剤 (20)	28	18
አ" ∫~- 1 (100)	PAG1 (2)	トリプ・チルフミン (0.1)	PGMEA (2100)	溶解 向上剤 (10)	26	16
ポリャー6 (100)	PAG1 (2)	トリブ・チルブミン (0.1)	PGMEA (2100)	-	70	3

【0122】表1~3の結果より、本発明の高分子化合 物を用いたレジスト材料は、F2エキシマレーザーにお いて髙感度で髙コントラスト(髙ヶ)を満たし、エッチ ング後の膜厚差が小さく、更にエッチング後の表面ラフ 30 【化19】

ネスが小さいことより、優れた耐ドライエッチング性を 有していることがわかった。

[0123]

$$+0$$
 $+ SO_3$ $+ SO_3$ $+ PAG 1$ $+ O$ $+ O$

【手続補正書】

【提出日】平成13年11月13日(2001.11.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】R'は水素原子、又はメチル基、エチル基、プロビル基、nーブチル基、イソブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基等の炭素数1~10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基であり、酸素、窒素、硫黄などのヘテロ原子を含んでいてもよい。Xはメチレン基、エチレン基、酸素原子又は硫黄原子である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正内容】

【0033】式(4)に示される三級アルキル基としては、tert‐ブチル基、トリエチルカルビル基、1‐

エチルノルボニル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロベンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、tert-アミル基等を挙げることができ、また(4)-1~(4)-16を挙げることができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】本発明フッ素アルコール含有シクロオレフィン/マレイミド共重合ポリマーは、シクロオレフィンモノマー側鎖に酸脱離性置換基を含有するが、密着性を向上させるための置換基を含むモノマー、ドライエッチング耐性を向上させるためのモノマー、(メタ)アクリレートモノマーに由来する単位を含んでいてもよい。密着性向上のためのモノマーとは、フェノール、酸無水物、エステル(ラクトン)、カーボネート、アルコール、カルボン酸、カルボン酸アミド、スルホン酸アミド、ケトンなどの親水性置換基を含むものであり、例えば下記式(6)-1~(6)-51のようなものが挙げられる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.' 識別記号 HOlL 21/027

(72)発明者 畠山 潤 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 渡辺 淳 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 原田 裕次 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 河合 義夫 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 笹子 勝 大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 遠藤 政孝 大阪府髙槻市幸町1番1号

(72)発明者 岸村 眞治 大阪府髙槻市幸町1番1号

(72)発明者 大谷 充孝 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内 FI デーマフート (参考) H O 1 L 21/30 5 O 2 R

(72)発明者 宮澤 覚 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 堤 憲太郎 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 前田 一彦 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 セントラル硝子株式会社内

F ターム(参考) 2H025 AA09 AB16 AC04 AD03 BE00 BE07 BE10 BF11 BG00 CB45 CC20 FA17

4J002 BH021 BK001 EB007 EB066
EB116 EC036 ED026 ED036
EE036 EH036 EH046 EJ038
EJ056 EN029 EN139 EQ017
ER007 EV237 EV247 EV297
FD207 FD208 FD310 GP03
4J100 AR09Q AR09R AR11Q AR11R
AR36P BA02R BA03Q BA15R
BA22R BB18Q BB18R BC03R
BC04R BC08R BC09R BC12R
BC22R BC23R BC53R CA04
CA05 JA38